भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 718
जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है ।
3 श्रावण, 1947 (शक)

भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र

718. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अनुमोदित सेमीकंडक्टर निर्माण और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन सुविधाओं के साथ कब तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है;

(ख) सरकार पीएलआई 2.0 घटक के अंतर्गत बैकवर्ड इंटीग्रेशन को किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना बना रही है, और तथा क्या उप-क्षेत्रीय लक्ष्यों एवं आयात प्रतिस्थापन की उपलब्धियों सहित कोई सार्वजनिक रोडमैप जारी किया जाएगा; और

(ग) भारत की महत्वपूर्ण कच्चे माल और लिथोग्राफिक उपकरणों पर निर्भरता को देखते हुए सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तक विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ठोस द्विपक्षीय ढांचा बनाया गया है या समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है:-

1. भारत में सिलिकॉन पूरक धातु-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (सीएमओएस) आधारित सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता।
2. भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता।
3. भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (माइक्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम सहित), फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना के लिए समरूप आधार पर पूंजीगत व्यय के 50% का वित्तीय समर्थन।

4. चिप डिजाइन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति आवेदन 30 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन 5 वर्षों में निवल बिक्री कारोबार के 6% से 4% का "परिनियोजन संबद्ध प्रोत्साहन" और प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन पात्र व्यय के 50% तक का उत्पाद संबद्ध डिजाइन प्रोत्साहन।

<u>भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण</u>

- सेमीकॉन इंडिया के तहत ₹1.55 लाख करोड़ के निवेश के साथ छह सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया।
- इन परियोजनाओं से 27,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- अनुमोदित परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) का उद्देश्य घटकों पर पूंजीगत व्यय सब्सिडी प्रदान करके बैकवर्ड इंटीग्रेशन को शामिल करना और घरेलू स्तर पर संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करना है।

आत्मनिर्भरता और नवाचार प्राप्त करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। इसके परिणाम इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि से स्पष्ट हैं।

#	2014-15	2024-25	टिप्पणी
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	1.9 लाख करोड़	11.3 लाख करोड़	~ 6 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (रु.)	38 हजार करोड़	3.27 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ	2	300	150 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का उत्पादन (रु.)	18 हजार करोड़	5.45 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का निर्यात (रु.)	1,500 करोड़	2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि
आयातित मोबाइल फोन (इकाइयों में)	कुल मांग का 75%	कुल मांग का 0.02%	

उद्योग का अनुमान है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए मूल्य संवर्धन में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) शुरू की गई है।

<u>इलेक्ट्रॉनिक्स</u> सं**<u>घटक विनिर्माण योजना:</u>**

- बजटीय परिव्यय: ₹22,919 करोड़
- लक्ष्य खंड: उप-असेंबली, बेयर कंपोनेंट, उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र और पूंजीगत उपकरण और उनकी उप-असेंबली।
- टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन, पूंजीगत प्रोत्साहन और हाइब्रिड प्रोत्साहन (दोनों का संयोजन) प्रदान करती है; प्रोत्साहन का एक हिस्सा रोजगार सृजन से भी जुड़ा हुआ है।
- इस योजना के लिए आवेदन वर्तमान में पोर्टल पर स्वीकार किए जा रहे हैं।
- योजना का पूरा विवरण ecms.meity.gov.in पर उपलब्ध है।

लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाने और पूरक शक्तियों का लाभ उठाने के अवसरों पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए, सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ और सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****